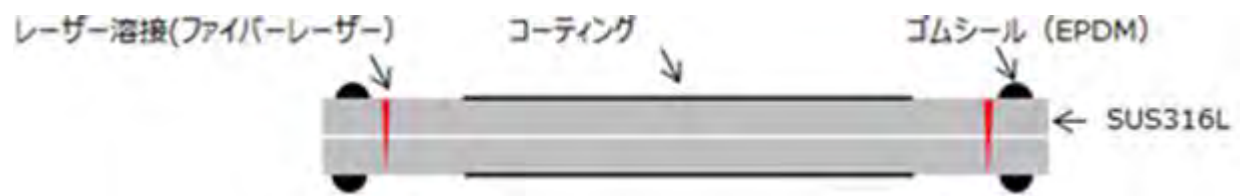
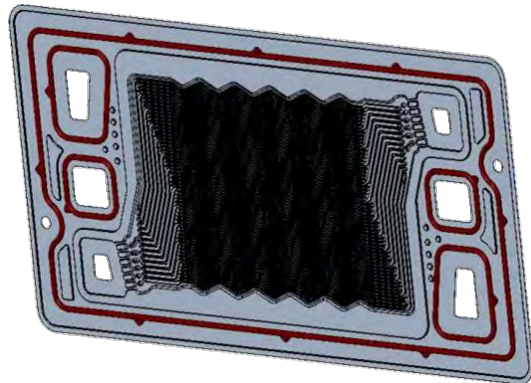


開発の狙い

一貫生産による低コスト化 接触抵抗を大幅に低減

セパレーター



プレス成形

均一な肉厚

狭ピッチ流路

均一肉厚

高い平坦性

ソリ量 2 mm以下



レーザー溶接

低歪、高シール性

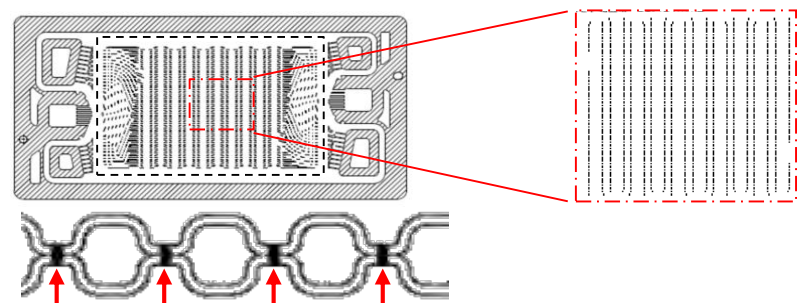
SUS薄板接合 (t=0.1)

高い平坦性

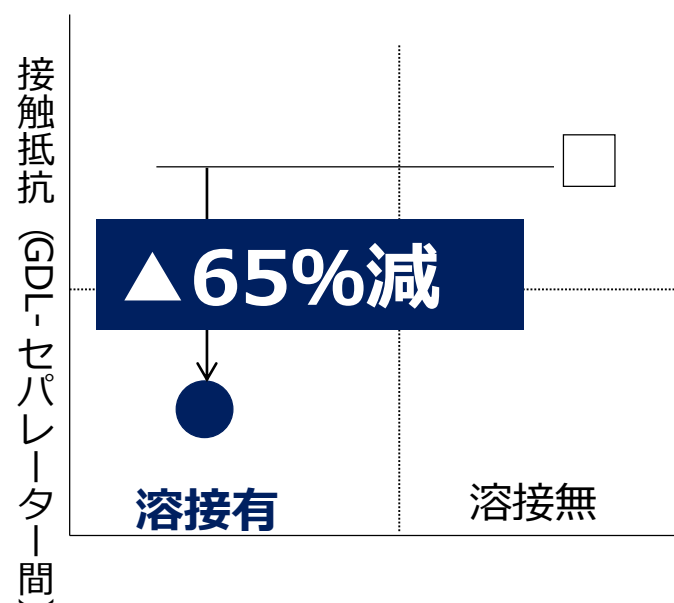
ソリ量 2 mm以下

低抵抗：導体抵抗

流路底で溶接接合



65%の接触低減効果有



コーティング

耐食性, 導電性

アフターコート

プレス後に表面処理

